



2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年11月13日

上場取引所 東

上場会社名 ワイエイシーホールディングス株式会社

コード番号 6298 URL <https://www.yac.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 百瀬 武文

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理統括本部長 (氏名) 畠山 督 TEL 042-546-1161

四半期報告書提出予定日 2023年11月13日 配当支払開始予定日 2023年12月6日

四半期決算補足説明資料作成の有無： 有

四半期決算説明会開催の有無： 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第2四半期の連結業績（2023年4月1日～2023年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第2四半期	11,506	4.8	710	50.2	861	49.1	700	115.1
2023年3月期第2四半期	10,976	△0.9	473	△34.0	577	△20.9	325	△37.9

(注) 包括利益 2024年3月期第2四半期 957百万円 (73.0%) 2023年3月期第2四半期 553百万円 (△11.3%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第2四半期	76.30	75.86
2023年3月期第2四半期	35.61	35.41

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年3月期第2四半期	42,165	16,517	39.1
2023年3月期	38,740	15,977	41.1

(参考) 自己資本 2024年3月期第2四半期 16,479百万円 2023年3月期 15,939百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期	—	25.00	—	50.00	75.00
2024年3月期	—	35.00	—	—	—
2024年3月期（予想）	—	—	—	40.00	75.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

3. 2024年3月期の連結業績予想（2023年4月1日～2024年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	30,000	24.4	3,000	100.5	2,900	88.1	2,100	128.0	228.64

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動：(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 有
新規 1社 (社名) 、除外 1社 (社名) ワイエイシイテクノロジーズ株式会社

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2024年3月期2Q	9,758,947株	2023年3月期	9,758,947株
② 期末自己株式数	2024年3月期2Q	569,080株	2023年3月期	583,942株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2024年3月期2Q	9,179,258株	2023年3月期2Q	9,144,364株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページの「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(会計方針の変更)	8
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	8
(会計上の見積りの変更)	8
(追加情報)	8
(セグメント情報等)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間(2023年4月1日～2023年9月30日)における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の対応が進み経済活動の活性化が図られ、緩やかではありますが回復傾向にあります。一方、ロシアによるウクライナ軍事侵攻の長期化、中東情勢の緊迫化、中国における個人消費・不動産市場の停滞等により景気後退への懸念が高まっております。

このような経済状況のもとで、当社グループは、刻々と変化する顧客ニーズを捉えた装置の開発と販売に努めてまいりました。その結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高115億6百万円(前年同四半期比4.8%増)、営業利益7億10百万円(前年同四半期比50.2%増)、経常利益8億61百万円(前年同四半期比49.1%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益7億円(前年同四半期比115.1%増)となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

(メカトロニクス関連事業)

クリーンコンベア等の各種自動搬送装置およびイオンビームミリング装置は堅調に推移しましたが、5G等の電子部品向けテーピング装置および自動機は、顧客の都合による設備投資の先送り等により停滞し、減収増益となりました。

これらの結果、メカトロニクス関連事業の売上高は49億78百万円(前年同四半期比3.9%減)となり、セグメント利益は5億80百万円(同23.7%増)となりました。

(ディスプレイ関連事業)

ドライエッチング装置の売上が停滞したことにより大幅に売上が減少しましたが、遠赤外線熱処理装置の売上が順調に拡大したことにより、セグメント利益が大幅に改善しました。

これらの結果、ディスプレイ関連事業の売上高は19億73百万円(同21.5%減)となり、セグメント利益は2億48百万円(前年同四半期はセグメント損失1億31百万円)となりました。

(産業機器関連事業)

ホームクリーニング事業から、医療リネン事業およびeコマース業界向け紙包装事業等へのビジネスモデルの転換、加えてAI光学式検査装置の製造販売等広域にわたる事業展開を図っておりますが、資材高騰等により減益となりました。

これらの結果、産業機器関連事業の売上高は4億93百万円(同18.5%増)となり、セグメント損失は2億44百万円(前年同四半期はセグメント損失17百万円)となりました。

(電子機器関連事業)

電力会社向け制御通信機器の販売並びに人工透析装置等の販売は堅調に推移し、増収増益となりました。

これらの結果、電子機器関連事業の売上高は40億60百万円(同41.7%増)となり、セグメント利益は3億62百万円(前年同四半期比249.5%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は315億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億83百万円増加しました。現金及び預金7億95百万円、商品及び製品1億22百万円減少しましたが、仕掛品19億82百万円、原材料・貯蔵品2億45百万円増加したことが主な増加要因です。固定資産は105億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億41百万円増加しました。投資有価証券12億79百万円、のれん5億47百万円増加等が主な増加要因であります。その結果、総資産は421億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億24百万円の増加となりました。

(負債)

流動負債は172億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億92百万円増加しました。固定負債は83億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億7百万円減少しました。長期借入金8億56百万円減少が主な減少要因であります。その結果、負債は256億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億84百万円の増加となりました。

(純資産)

純資産は165億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億39百万円増加しました。その結果、自己資本比率は39.1%となり、1株当たり純資産は1,793円22銭となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

半導体業界における車載向け関連製品の需要増により受注は好調に推移しましたが、部材納期の遅延、原価高により売上高、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益等が前回発表（2023年5月11日に公表しました通期の業績予想）を下回る見込みとなり、2024年3月期の連結業績予想（通期）を変更いたしました。

仔細は、本日公表の「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,628	5,832
受取手形及び売掛金	11,282	11,405
有価証券	0	0
商品及び製品	1,371	1,249
仕掛品	7,695	9,677
原材料及び貯蔵品	2,114	2,360
その他	1,136	1,183
貸倒引当金	△121	△117
流動資産合計	30,108	31,592
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	5,107	5,148
減価償却累計額	△3,466	△3,520
建物及び構築物(純額)	1,641	1,627
機械装置及び運搬具	2,489	2,755
減価償却累計額	△2,000	△2,218
機械装置及び運搬具(純額)	489	537
工具、器具及び備品	3,751	3,829
減価償却累計額	△3,388	△3,474
工具、器具及び備品(純額)	363	355
土地	3,961	4,025
リース資産	406	423
減価償却累計額	△194	△220
リース資産(純額)	212	203
建設仮勘定	743	521
有形固定資産合計	7,412	7,270
無形固定資産		
のれん	—	547
ソフトウェア	51	50
リース資産	101	111
電話加入権	20	20
その他	15	242
無形固定資産合計	189	973
投資その他の資産		
投資有価証券	308	1,587
長期貸付金	9	6
繰延税金資産	563	492
長期滞留債権等	242	244
その他	171	263
貸倒引当金	△264	△266
投資その他の資産合計	1,030	2,329
固定資産合計	8,631	10,573
資産合計	38,740	42,165

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,252	6,032
短期借入金	6,713	9,244
リース債務	89	81
未払法人税等	370	368
賞与引当金	425	384
製品保証引当金	62	75
未払費用	297	328
前受金	171	266
その他	296	491
流動負債合計	13,680	17,272
固定負債		
社債	500	550
長期借入金	6,827	5,970
リース債務	250	271
繰延税金負債	79	88
退職給付に係る負債	1,321	1,329
資産除去債務	54	45
事業整理損失引当金	20	8
その他	28	111
固定負債合計	9,082	8,375
負債合計	22,763	25,648
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,801	2,801
資本剰余金	3,668	3,697
利益剰余金	9,879	10,120
自己株式	△497	△484
株主資本合計	15,852	16,135
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△2	103
為替換算調整勘定	91	242
退職給付に係る調整累計額	△1	△1
その他の包括利益累計額合計	87	344
新株予約権	37	37
純資産合計	15,977	16,517
負債純資産合計	38,740	42,165

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
売上高	10,976	11,506
売上原価	8,304	8,316
売上総利益	2,671	3,189
販売費及び一般管理費		
役員報酬及び給料手当	893	977
賞与引当金繰入額	86	74
福利厚生費	35	37
賃借料	90	98
業務委託費	75	78
研究開発費	191	159
減価償却費	70	117
その他	754	935
販売費及び一般管理費合計	2,198	2,479
営業利益	473	710
営業外収益		
受取利息	2	1
受取配当金	51	2
為替差益	75	119
受取賃貸料	8	8
補助金収入	—	40
持分法による投資利益	—	2
その他	20	40
営業外収益合計	158	215
営業外費用		
支払利息	42	50
有価証券売却損	—	2
持分法による投資損失	4	—
その他	7	11
営業外費用合計	54	64
経常利益	577	861
特別利益		
固定資産売却益	—	13
負ののれん発生益	—	145
関係会社株式譲受益	—	118
特別利益合計	—	276
特別損失		
固定資産除売却損	2	1
特別損失合計	2	1
税金等調整前四半期純利益	574	1,136
法人税、住民税及び事業税	186	395
法人税等調整額	63	40
法人税等合計	249	435
四半期純利益	325	700
親会社株主に帰属する四半期純利益	325	700

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
四半期純利益	325	700
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△3	105
為替換算調整勘定	233	151
退職給付に係る調整額	△2	0
その他の包括利益合計	227	257
四半期包括利益	553	957
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	553	957
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

2023年4月1日を効力発生日として、連結子会社である株式会社ワイエイシイデンコーを吸収合併存続会社、連結子会社であったワイエイシイテクノロジーズ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行ったことにより、第1四半期連結会計期間よりワイエイシイテクノロジーズ株式会社を連結の範囲から除外しております。

なお、本合併は、同一セグメントの連結子会社間の合併であるため、当社連結業績への影響は軽微であります。

(会計上の見積りの変更)

該当事項はありません。

(追加情報)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				合 計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	メカトロニク ス関連事業	ディスプレイ 関連事業	産業機器 関連事業	電子機器 関連事業			
売上高							
外部顧客への 売上高	5,179	2,513	416	2,866	10,976	—	10,976
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	0	14	0	0	15	△15	—
計	5,180	2,528	416	2,866	10,991	△15	10,976
セグメント利益 又は損失(△)	469	△131	△17	103	424	48	473

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額48百万円は、各報告セグメントに配分しない全社収益及び全社費用であります。全社収益は主に各報告セグメントに帰属する連結子会社からの経営管理料等530百万円であります。また、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用△481百万円であります。

2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				合 計	調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	メカトロニク ス関連事業	ディスプレイ 関連事業	産業機器 関連事業	電子機器 関連事業			
売上高							
外部顧客への 売上高	4,978	1,973	493	4,060	11,506	—	11,506
セグメント間の 内部売上高又は 振替高	0	20	—	0	21	△21	—
計	4,978	1,994	493	4,060	11,528	△21	11,506
セグメント利益 又は損失(△)	580	248	△244	362	946	△236	710

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額△236百万円は、各報告セグメントに配分しない全社収益及び全社費用であります。全社収益は主に各報告セグメントに帰属する連結子会社からの経営管理料等269百万円であります。また、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用△505百万円であります。

2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

産業機器関連事業において、J Eインターナショナル株式会社及び株式会社GDテックの株式を取得し、連結の範囲に含めたことにより、のれんが発生しております。当第2四半期連結累計期間におけるのれんの増加額は547百万円であります。

(重要な負ののれん発生益)

電子機器関連事業において、当第2四半期連結会計期間に宝生産業株式会社の株式を取得し、連結の範囲に含めたことにより、負ののれん発生益を認識しております。

当第2四半期連結累計期間における負ののれん発生益の計上は145百万円であります。なお、負ののれん発生益は特別利益のため、上記セグメント利益には含まれておりません。